

深圳市大为创新科技股份有限公司

关于控股子公司取得外观设计专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市芯汇群微电子有限公司（以下简称“芯汇群”）于近日收到国家知识产权局颁发的3项《外观设计专利证书》，具体情况如下：

（一）外观设计名称：固态硬盘测试板（SATA）

- 1、设计人：贺义
- 2、专利号：ZL 2020 3 0167818.9
- 3、专利申请日：2020年4月22日
- 4、专利权人：深圳市芯汇群微电子有限公司
- 5、授权公告日：2020年8月25日
- 6、专利权期限：十年（自申请日起算）

（二）外观设计名称：固件烧录器（USB转SATA）

- 1、设计人：贺义
- 2、专利号：ZL 2020 3 0167492.X
- 3、专利申请日：2020年4月22日
- 4、专利权人：深圳市芯汇群微电子有限公司
- 5、授权公告日：2020年9月8日
- 6、专利权期限：十年（自申请日起算）

（三）外观设计名称：接口转接板（MSATA转SATA）

- 1、设计人：贺义
- 2、专利号：ZL 2020 3 0167389.5
- 3、专利申请日：2020年4月22日
- 4、专利权人：深圳市芯汇群微电子有限公司

5、授权公告日：2020年10月2日

6、专利权期限：十年（自申请日起算）

上述专利为芯汇群自主研发取得，其所涉及的技术及应用领域与公司新一代信息技术业务相关。截至目前，芯汇群已获得 10 项实用新型专利证书，3 项外观设计专利证书，38 项计算机软件著作权登记证书，5 项集成电路布图设计登记证书。

上述专利的取得暂不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，进一步完善公司的知识产权保护体系，提升公司的竞争力。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 22 日